

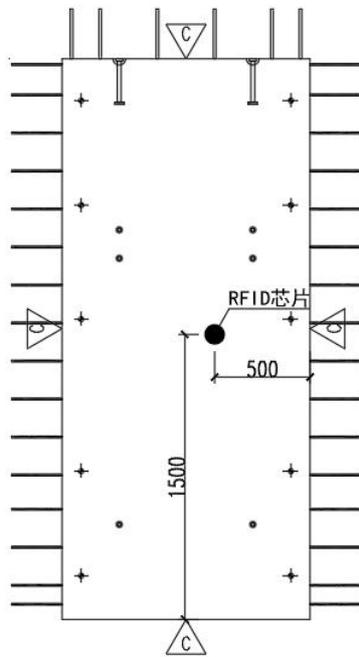
附件 2

预制构件电子芯片（RFID）植入定位规则

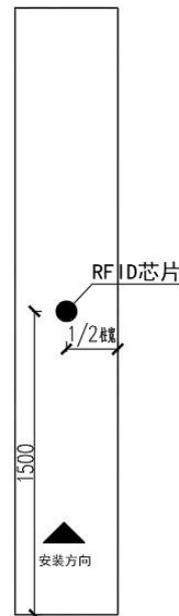
1、预制构件 RFID 芯片埋置深度为浅埋构件表面或埋于距构件表面 20mm 处。

2、预制内墙板的 RFID 芯片植入部位，植入面为内墙板生产时的上表面（内墙板紧贴模台的一面为下表面，外露的一面为上表面），高度距墙体底部 1.5 米，纵向离墙体右边沿 0.5 米处（图一）。

3、预制外墙板的 RFID 芯片植入部位，植入面面向建筑物内侧，高度距底边 1.5 米，纵向离右边沿 0.5 米处（图一）。



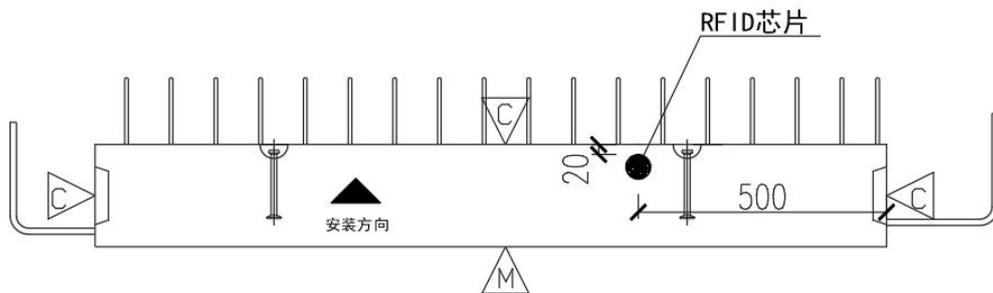
图一



图二

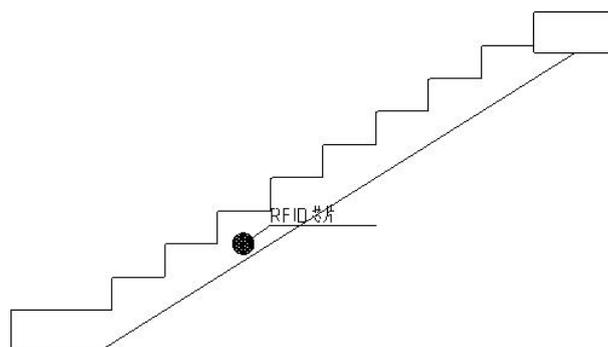
4、预制柱的 RFID 芯片的植入部位，植入面位于柱子安装方向标记一侧。高度距底边 1.5 米，柱宽的 1/2 处（图二）。

5、预制梁的 RFID 芯片植入部位，植入面位于梁侧面，放置安装方向标记一侧的右边。距梁上沿 20mm，距右侧边沿 500mm 处（图三）。



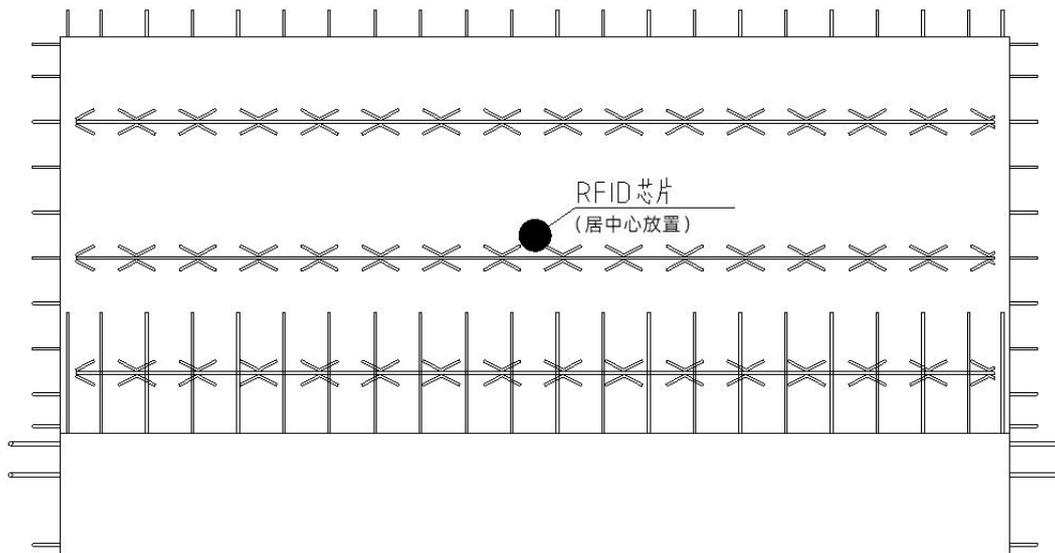
图三

6、预制楼梯的 RFID 芯片植入部位，位于自下至上第三个踏步靠栏杆一侧（如栏杆一侧为隔墙，则植入位于自下至上第三个踏步板底中间）（图四）。



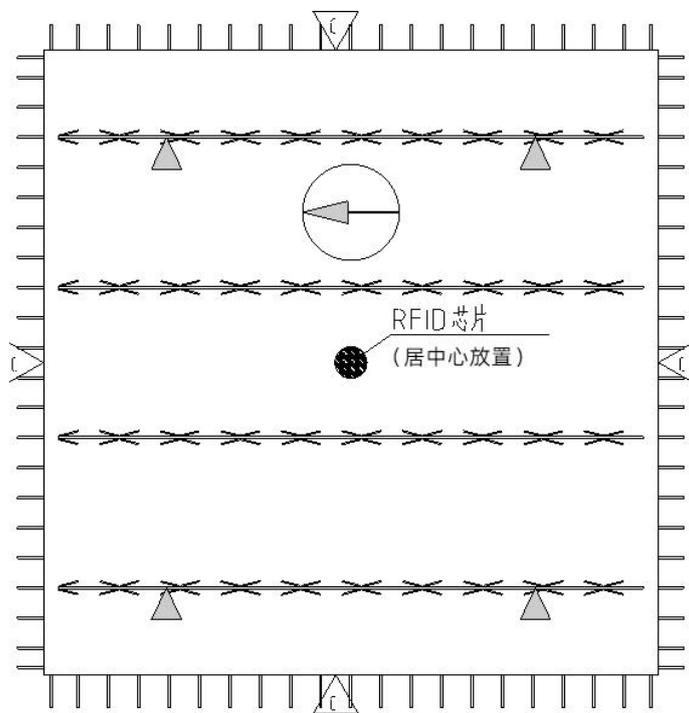
图四

7、预制阳台及空调板 RFID 芯片的植入部位，植入点为阳台板底面正中间处（图五）。



图五

8、预制楼板 RFID 芯片的植入部位，植入面位于预制楼板正中间底板处（图六）。



图六